

Borderlessを合言葉に、ベトナムの開発センターと連携

LSI需要の高まりと 設計開発技術者の育成

世界の半導体市場の伸び率は昨年と比較して鈍化傾向にあります。依然として半導体市場規模の成長は続いています。既存の製品はもとより、IoTや自動車のEV化・自動運転の導入など最先端の製品に組み込まれるLSIの需要が年々高まっているためです。昨今では、こうした景気を反映し、メモリ、センサーなどの開発需要が増加しています。それに伴い、半導体設計開発の技術者不足が深刻な問題となっています。

当社では、東芝のベトナム現地法人であるTSDV (Toshiba Software Development Vietnam) と連携し、ベトナムから人材を受け入れ半導体設計技術者としての育成・活用を進めています。

TSDVは、エンベデッド分野をはじめとする東芝グループのソフトウェア開発の海外中核拠点として、高品質で信頼性の高いソフトウェアを開発・提供することを目的に設立され、ソフト

ウェア開発、最先端技術の実装や製品化、ソフトウェア品質テストなどを行っています。2016年8月には、当社と連携したLSI設計開発も視野に入れ、TSDV内にHDC (Hanoi Design Center) を開設しました(図-1)。

TSDVで新卒採用した人材は、約2年間当社に出向して技術教育とOJTを受け、ハードウェア技術者として経験を積みます。その後、ベトナムに帰国しTSDVの社員としてHDCにて当社からの半導体設計業務を請け負います(図-2)。

多様な文化を共有した LSI設計を推進

TSDVが毎年採用する人材は、大学や大学院を卒業した20代前半の若者です。彼らの中には海外へ行くのが初めての社員も多くいます。

日本における2年の研修期間では、LSIの基礎教育と合わせて日本語の特別教育も行っています。また、彼らが研修を終えて帰国した後も、私たち

と一緒に仕事をする際に意思疎通を深めるため、言葉だけではなく日本文化にも親しんでもらう取り組みも行っています。新年には会社近くの神社に行きベトナムの神社との違いを実感してもらい、春にはお花見に誘って当社従業員との交



流を図り、夏には浴衣を着て日本のお祭りを体験してもらいます。休日には日本各地を旅行し、風土や景色、食べ物、インフラなどベトナムとのさまざまな違いを実感しています。言語や文化の異なる国の人と共に働くことは、決して容易ではありませんが、相手の文化の違いをお互いに理解することが大切です。

彼らは、技術の習得スピードが極めて速く、学ぶ意欲も旺盛で、仕事にやりがいを持って取り組んでいます。このようなことを踏まえて、LSIソリューション事業部では、高い技術力を持った優れた人材がいて、安定したパートナー企業であるTSDVと連携することは重要であると捉えています。

2018年には、半導体設計開発の需要拡大を受けて、HDCでの開発を本格化しました。先のビジネス拡大を見据え、今後も電話会議や短期の海外出張、設計環境の整備など日本とベトナムの距離を縮める工夫を重ねていきます。TSDVでは、2021年には約20名の技術者がHDCでLSI開発業務に従事する計画を進めており、長期的にTSDVと連携し協力体制を築いていきます。

(LSIソリューション事業部 石井 敦子)

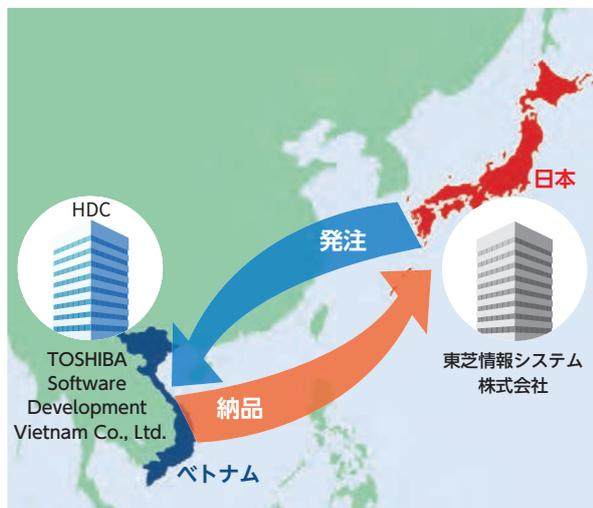


図-1 TSDVとの連携概要